

三友電子工業(株)小宅課長様

発行日:2012年 1月20日

不具合管理No. 43F-1-006

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日:2012年 1月26日

承認	調査	担当
黒岩 12.1.24 映次	黒岩 12.1.24 映次	黒岩 12.1.24 映次

協
力
工
場
記
入

図 番	503186-2029
品 名	MICRO SD CARD CONN SWICH
ロットNo	11.12.02.A.Z.081
発生日	2012年1月20日
不良数量	8,000個
不良率	21/3,221

内容

めっき厚薄い
めっき厚:規格値0.03MIN
実測値:0.01~0.02



処 置

—

協
力
工
場
記
入

1. 確認内容

モレックス様大連工場より、めっきロットSU071211-052K1-009の巻き芯側のAuめっき厚が規格より薄くなっているとのこと指摘をいただきました。
生産変化点は治具洗いの生産始めのロールであること、他条で治具洗いの時間帯に重なっていたことがあります。生産記録には、画像処理装置の反応履歴は2箇所ありました。(始めより1,270ピン目と6,000ピン目) 6,000ピン付近は変形除去をし継ぎ目1箇所作成した履歴がありました。
保管サンプルのAuめっき厚は、前後ロールを含め、0.04~0.05mmあり、規格を満たしておりました。(別紙1)

返却品の処置(数量明記)

返却品はございません。
(3,221pcsの波及完成品は廃棄処分
とご連絡をいただいております。)

2. 発生原因

本製品の生産が始まると同時に、他条で治具洗いの作業が始まり、何らかの振動で製品がAuフラッシュめっき治具より浮き上がりを起こし、局所的なAu薄めっきとなりました。(Auめっき厚規格0.03mm以上に対し、0.01~0.02mm)
画像装置は2箇所の反応履歴が有りましたが、オンラインの確認では2箇所の内1箇所(1,270ピン目)での変形はなく消し込みがされておりました。

4. 流出原因

画像反応の有った2箇所の内、6,000ピン目は再検で変形を除去致しましたが、1,270ピン目は画像装置のオンライン確認で変形なしと消し込みがなされていたので、再検を行いませんでした。
めっき厚の検査においても規格を満たしており合格と致しました。

3. 発生防止対策

Auフラッシュめっき治具からの浮き上がり防止策として案内ローラーをAuめっき工程に設置致します。

5. 流出防止対策

本製品はAuフラッシュ部の規格が厳しいため、画像反応があった部分は、明らかな変形以外は薄めっきの観点で全検することとし、鍍金作業標準カードの注意事項に追記いたします。

実施日: 2012年 1 月 26 日

実施日: 2012年 1 月 26 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品	仕掛品
なし	なし

回答日: 2012年 1 月 23 日

承認	調査	作成
黒岩 12.1.23 星野	品管 12.1.23 金堂	品管 12.1.23 小宅

標準類改訂 (有) ・ 無 (鍍金作業標準カード)

協
力
工
場
記
入

確
認

対策後、12.03.15.A.F.0001-0020~12.03.26.A.G.0047-0076
の計5ロットにおいて同不具合無しの為、有効性ありと判断致し。

承認	調査	確認者
黒岩 12.4.13 映次	黒岩 12.4.13 映次	黒岩 12.4.13 映次

(株) 三友

Doc. A-004 (Rev. 1.00)

